

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

我們申請[編纂]，旨在將我們的增長推進至新階段，並增強我們在芯片定制服務市場的競爭地位。具體而言，我們認為[編纂]將(i)提升我們在國內外市場的公眾形象及曝光度，以便我們擴大客戶群並提升品牌知名度；(ii)進一步拓寬我們進入國際資本市場的渠道，使我們在[編纂]時及之後能更高效地籌集資金以支持我們的增長；及(iii)吸引人才及激勵僱員。此外，我們選擇於香港[編纂]，是由於香港是通往國際資本市場的戰略門戶。

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂]用途

經扣除[編纂]佣金及費用以及我們就[編纂]已付及應付的其他估計[編纂]後，假設[編纂]並無獲行使，並基於假設[編纂]為每股[編纂]港元（即[編纂][編纂]每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）計算，我們估計將收取的[編纂][編纂]為[編纂]百萬港元。

下表載列未來五年[編纂][編纂]用途概要。該等計劃乃基於假設而定，並受不確定因素（包括「風險因素」一節所述者）影響。因此，我們無法向閣下保證我們的計劃將如期進行或我們的目標將能完全達成。

| | 2026年 至2027年 | 2028年 至2029年 | 2030年 至2031年 | 2026年 至2031年總計 | 佔[編纂][編纂] 總額百分比 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | % |
| | (以百萬計，百分比除外) | | | | |
| 增強我們的核心技術 及研發能力..... | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 加強與上下游合作夥伴 的協作..... | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 擴張我們的全球版圖及 加強國際品牌知名度... | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 營運資金及其他一般 企業用途..... | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 總計..... | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | 100.0% |

未來計劃及[編纂]用途

根據我們的戰略，我們計劃按以下所載用途及金額使用[編纂][編纂]：

- [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於增強我們的核心技術及研發能力，重點開發及迭代下一代關鍵IP，以進一步鞏固我們在高速數據接口IP、高速存儲接口IP及芯粒互連IP領域的領先地位－具體而言，
 - [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於繼續開發下一代高速數據接口IP，重點進行112G長距離SerDes及224G長距離SerDes的研發及硅驗證，以滿足擁有大量互連加速器的海量AI模型集群對高帶寬及低延遲的要求，從而在先進工藝節點上實現行業領先的性能指標，並加強我們在數據中心網絡互連方面的優勢。我們目前正在研發112G長距離SerDes，並計劃為224G長距離SerDes的研發分配資源。我們計劃留用現有人才並招聘新的專門IP SerDes設計專業人員，以及少量前端設計、驗證及數字化後端設計工程師。預期到2031年，將有一支超過[50]名人才組成的團隊專門從事該研發計劃。於2026年至2031年，該等專業人員的預期平均年薪將介於人民幣[編纂]百萬元至人民幣[編纂]百萬元。此外，我們將採購服務器及其他計算設備，以支持該研發計劃；
 - [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於迭代高速存儲接口IP，通過(i) 加速HBM3e控制器及PHY IP的量產驗證及(ii)繼續研發LPDDR6及3D DRAM控制器，從而為萬億參數AI模型訓練提供超高帶寬及低延遲的存儲解決方案，並滿足未來三至五年AI算力需求的快速增長。我們目前正對HBM3e控制器及PHY IP進行工程驗證。我們亦已開展關於LPDDR6及3D DRAM控制器的研究，並計劃繼續向該等項目的商業化分配資源。我們計劃留用現有人才並招聘新的IP並行接口設計專家、前端設計及驗證工程師，以及數字化後端設計工程師。預期到2031年，將有一支超過[50]名人才組成的團隊專門從事該研發計劃。於2026年至2031年，該等專業人員的預期平均年薪將介於人民幣[編纂]百萬元至人民幣[編纂]百萬元。此外，我們將採購服務器及其他計算設備，以支持該研發計劃；
 - [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於升級我們的芯粒異構集成平台，通過利用我們參與制定芯粒互連技術國家標準的優勢，開發與UCIe等國際主流標準兼容的標準化芯粒產品矩陣，從而實現從定制化設計向更為模組化組裝模式的轉型。我們目前採用基於UCIe等國際主流標準的標準化芯粒解決方案，並已成功實施多個項目。自2027年起，我們計劃分配更多資源以推進專有芯粒相關IP的開發。我們將收購該領域的合適IP。此外，我們將留用現有人才並招聘新的前端設計及驗證工程師以及後端設計專業人員。預期到2031年，

未來計劃及[編纂]用途

將有一支約[30]名人才組成的團隊專門從事該研發計劃。於2026年至2031年，該等專業人員的預期平均年薪將介於人民幣[編纂]百萬元至人民幣[編纂]百萬元。此外，我們將採購服務器及其他計算設備，以支持該研發計劃；及

- [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於提升我們在先進工藝節點適配及工具鏈開發方面的能力，通過(i)持續投入3納米、2納米及更先進節點的研發及(ii)進一步優化我們自動化IC技術平台內的智能工具鏈，以提高我們適配前沿工藝技術的能力。自2027年起，我們計劃逐漸分配資源用於在更先進工藝節點(包括3納米及2納米)的設計研究。我們計劃留用現有人才並招聘新的高階前端設計及驗證工程師以及少量數字化後端設計工程師。預期到2031年，將有一支超過[30]名人才組成的團隊專門從事該研發計劃。於2026年至2031年，該等專業人員的預期平均年薪將介於人民幣[編纂]百萬元至人民幣[編纂]百萬元。此外，我們將採購服務器及計算設備，以支持該研發計劃。
- [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於加強與上下游合作夥伴的協作，以建立安全、可控且高效的閉環產業生態系統 – 具體而言，
 - [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於進一步開發我們與半導體代工廠的工藝協作框架，特別是(i)為全球領先代工廠就3納米及2納米等先進節點進行早期研發，以便獲取最新的工藝設計套件、模型庫及產能支持；及(ii)為國內主流代工廠開發及驗證基礎IP，以支持國產工藝技術在高階AI芯片中的應用。我們是三星在中國的設計解決方案合作夥伴，目前正為一家領先的國內半導體代工廠開發及驗證先進節點的基礎IP。為加強與國內主要晶圓代工廠在更先進工藝節點上的合作，我們計劃收購該領域的合適IP、開發模擬佈局設計、留用現有人才，並招聘新的高階前端設計、驗證及數字化後端設計專業人員。預期到2031年，將有一支約[30]名人才組成的團隊專門從事該計劃。於2026年至2031年，該等專業人員的預期平均年薪將介於人民幣[編纂]百萬元至人民幣[編纂]百萬元。此外，我們將採購服務器及計算設備，以支持該開發戰略；
 - [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於加強我們與先進封裝供應商的協作並維持穩定產能，通過(i)與國內半導體封裝測試服務商合作，開發適配2.5D/3D技術的協同設計流程，及(ii)鎖定專用生產線的產能，以在高度互連場景下實現複雜大規模芯片的良率提升及可靠交付。我們在2.5D/3D技術方面已積累豐富的成功經驗，並與國內領先的封裝測試企業建立了緊密的合作關係。展望未來，我們計劃加強與該等企業在更先進工藝技術上的合作。我們將留用現有人才並招聘新的高端2.5D/3D設計專業人員。預期到2031年，將有一支約[20]名人才組成的團隊專門從事該計劃。於2026年至2031年，該等專業人員的預期平均年薪將介於人民幣[編纂]百萬元至人民幣[編纂]百萬元。此外，我們可能會動用部分[編纂]，以鎖定專用先進封裝生產線的產能，並採購服務器及計算設備，以支持該計劃；及

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於開發有機結合技術平台與生態系統合作夥伴的AI硬件生態系統，通過連接算法供應商、特定應用場景的系統開發商及終端用戶，以降低高性能AI ASIC的開發門檻，並推動邊緣AI服務器、互連芯粒及內存組件的商業化及更廣泛採用。我們計劃留用現有人才並招聘新的高階數字化後端設計專業人員。預期到2031年，將有一支約[15]名人才組成的團隊專門從事該計劃。於2026年至2031年，該等專業人員的預期平均年薪將介於人民幣[編纂]百萬元至人民幣[編纂]百萬元。
- [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於擴張我們的全球版圖及加強國際品牌知名度 – 具體而言，
 - [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於建立全球營銷及服務網絡，通過(i)在全球主要半導體中心(如歐洲、中東及美國)建立及擴張銷售辦事處及技術支持中心，(ii)在該等地區組建本地化服務團隊，及(iii)租賃辦公物業旨在提升國際市場佔有率及滲透率。預期新的本地化服務團隊將由最多[25]名人員組成，於2026年至2031年，預期平均年薪將介於人民幣[編纂]百萬元至人民幣[編纂]百萬元；
 - [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於品牌建設及市場推廣，通過參加頂級國際行業會議及展覽、媒體宣傳以及我們銷售及營銷人員的差旅開支，以提高我們的曝光度，並增強我們作為中國及全球領先芯片定制服務供應商的 brand 知名度及行業影響力；及
 - [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於對IC行業中專注於IP研發公司的策略性投資及併購，以增強我們的技術實力並擴張我們在更多區域市場的版圖。有關我們潛在目標遴選標準的更多詳情，請參閱「業務 – 我們的戰略」。
- [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定為[編纂]範圍的高位或低位，[編纂]的[編纂]將分別增加或減少[編纂]百萬港元或[編纂]百萬港元。在此等情況下，我們將按比例增加或減少分配至上述用途的[編纂]。

倘[編纂]獲悉數行使，基於假設[編纂]為每股[編纂]港元(即[編纂]每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，[編纂]將額外收取[編纂]百萬港元的[編纂]。根據[編纂]，本公司可能須[編纂]合共最多[編纂]股額外股份。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]的[編纂]不足以撥付上述用途，我們擬通過經營活動所得現金、銀行借款及其他借款相結合的方式撥付缺口。倘[編纂]的[編纂]未有立即用於上述用途，我們僅會將該等資金存入持牌商業銀行或其他認可財務機構（定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規）的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適用披露要求。